

修订记录 / Revised record

[illegible]

描述 / Descriptions

三 极 管 封 装 形 式 3 3 塑 料 封 装 半 导 体

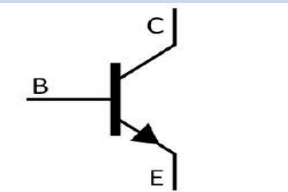
特征 / Features

低 电 流

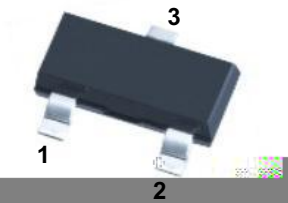
用途 / Applications

一 般 弱 电 压 用

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



关 关 关

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

	路	路	路

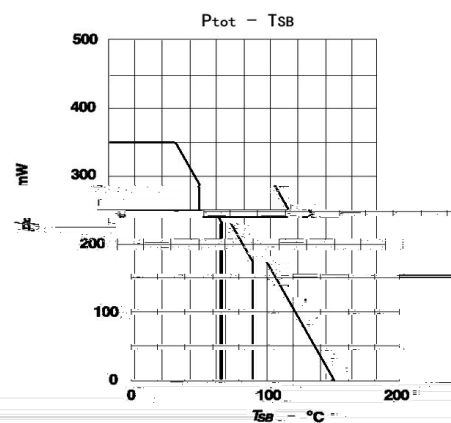
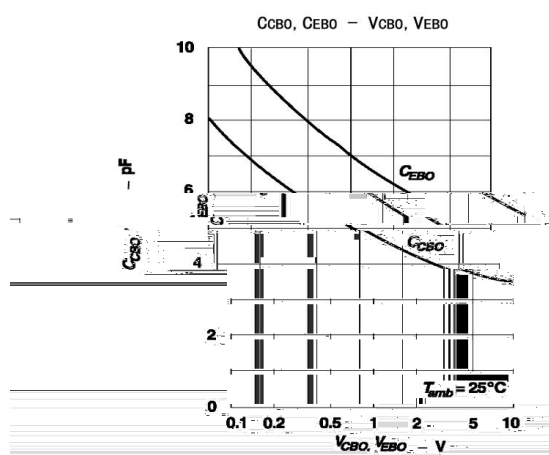
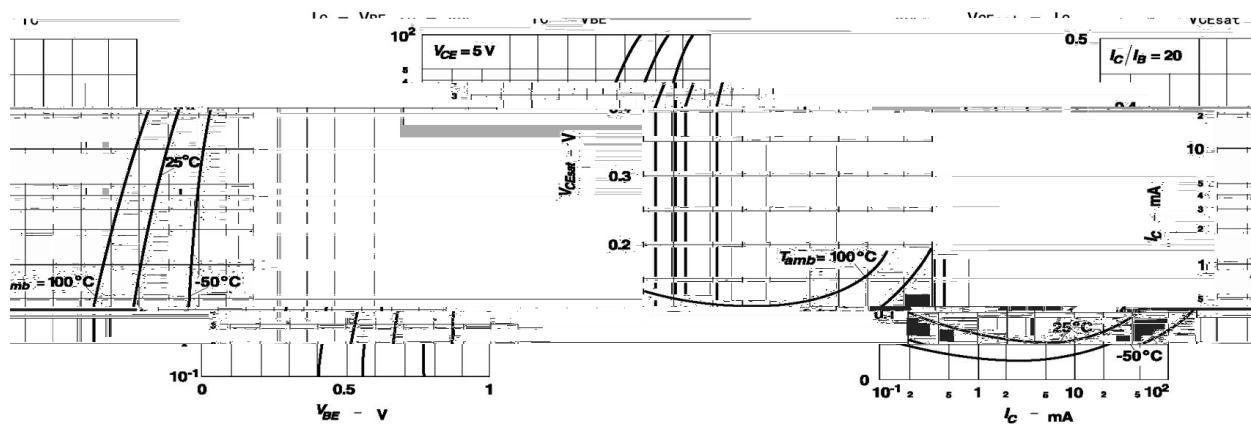
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

		符	
			℃
		~	℃

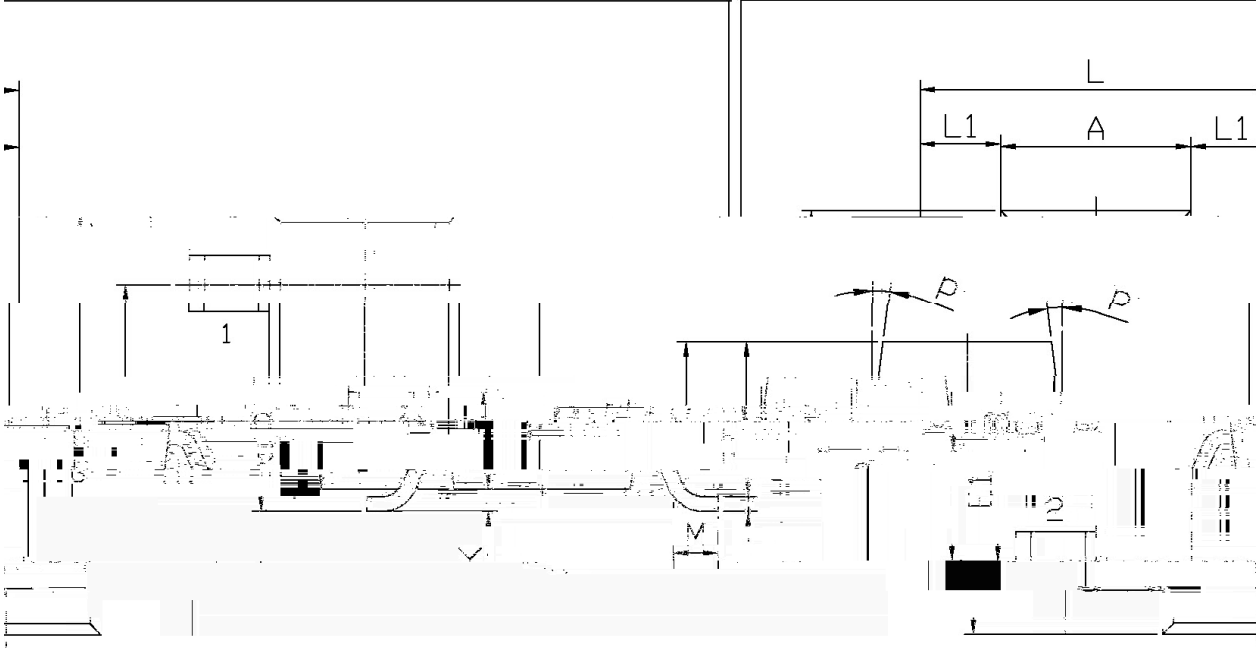
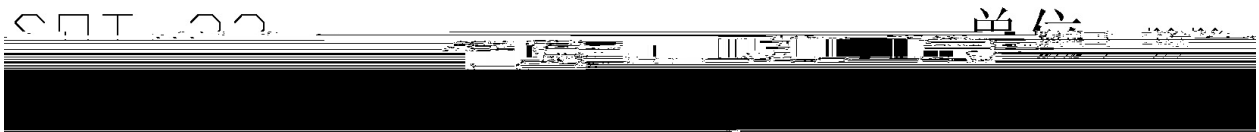
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

			符	总 符	般 符	

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

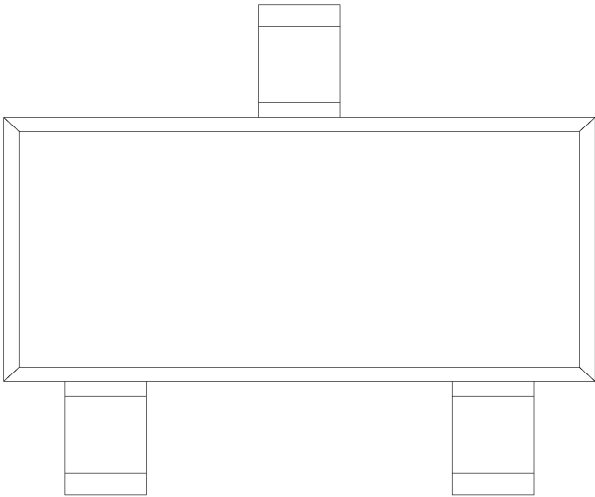


外形尺寸图 / Package Dimensions



Symbol	Dimensions in millimeters		Symbol	Dimensions in millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L1	0.45	0.65	C1	0.91	1.20
A	1.15	1.50	L	0.25	
B	2.70	3.10	K	0	
E	1.70	2.10	M	0.20	
E1	0.85	1.05	P	7	
b	0.35	0.55			

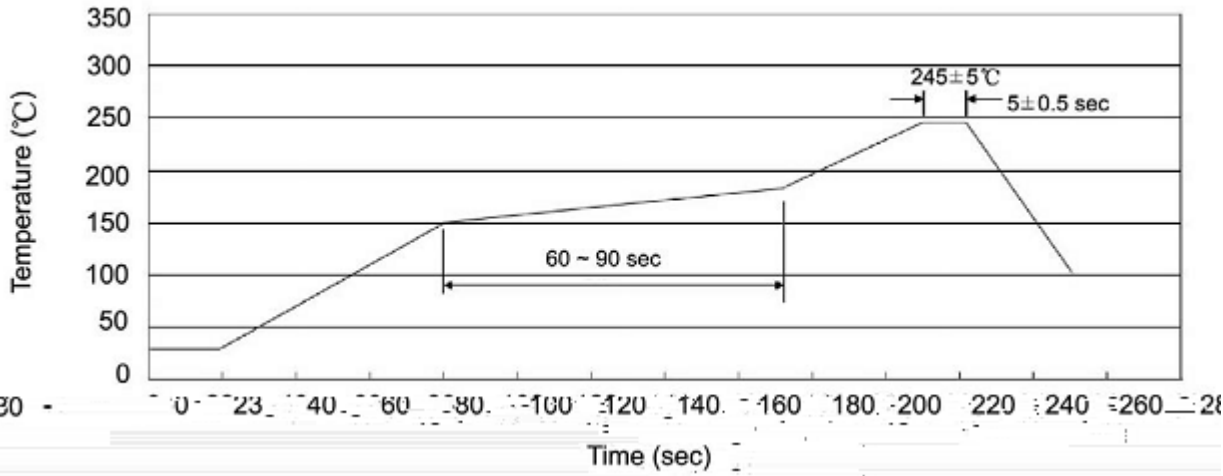
印章说明 / Marking Instructions



关
关 装 的
关 总 的

6 0 0 10.566815.694 47.509T3004

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：热

、预热温度 ~ °C，时间 ~

、峰值温度 ± °C，时间持续为 ±